

衛生福利部 函

機關地址：11558 台北市南港區忠孝東路六段488號
傳 真：(02)2653-1283
聯絡人及電話：陳曉錚(02)2787-7228
電子郵件信箱：hsiao Cheng@fda.gov.tw

70173
台南市東區崇德路677號

受文者：台南市儀器商業同業公會

發文日期：中華民國110年4月29日
發文字號：衛授食字第1101200800號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：「醫療器材創新科技研究發展獎勵辦法」，業經本部會銜經濟部於中華民國110年4月29日以衛授食字第1101200795號、經工字第11004601950號令訂定發布施行，請查照。

說明：

- 一、旨揭「醫療器材創新科技研究發展獎勵辦法」草案，業經本部於中華民國109年7月6日以衛授食字第1091201055號公告於行政院公報，踐行法規預告程序。
- 二、旨揭發布令請至行政院公報資訊網、本部網站「衛生福利法規檢索系統」下「最新動態」網頁或本部食品藥物管理署網站「公告資訊」下「本署公告」網頁自行下載。

正本：經濟部、經濟部生技醫藥產業發展推動小組、台灣藥學會、台北市生物產業協會、台灣細胞醫療促進協會、南港生技育成中心、生物科技產業研究中心、生技產業深耕學院、馬偕紀念醫院生醫發展暨創新育成中心、臺灣大學SPARK計畫辦公室、社團法人國家生技醫療產業策進會、長庚大學、中臺科技大學、大仁科技大學、高雄醫學大學、臺北醫學大學、國立陽明交通大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、財團法人工業技術研究院、台灣醫院協會、東海大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、社團法人臺灣臨床藥學會、中央研究院、財團法人國家衛生研究院、國立臺東大學、國立高雄大學、國立清華大學、國立臺灣大學、國防醫學院、國立成功大學、中國醫藥大學、大葉大學、大同大學、中原大學、中華醫事科技大學、弘光科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、亞洲大學、國立中央大學、國立中興大學、逢甲大學、義守大學、銘傳大學、新北市醫療器材商業同業公會、台灣醫療器材門市發展協會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、臺北市醫療器材商業同業公會、桃園市醫療器材商業同業公會、臺中市醫療器材商業同業公會、彰化縣醫療器材商業同業公會、嘉義市醫療器材商業同